公司代码：688037　　公司简称：芯源微

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于 2023 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），以此计算共计拟派发 37,047,359.60 元（含税）。拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.8 股，不送红股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 92,618,399 股，若以此为基数计算，公司拟合计转增 44,456,831 股，本次转增后公司总股本将增加至 137,075,230 股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准）。

该利润分配及资本公积转增股本方案尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	芯源微	688037	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	李凤莉	刘书杰
办公地址	辽宁省沈阳市浑南区彩云路 1 号	辽宁省沈阳市浑南区彩云路 1 号
电话	024-86688037	024-86688037
电子信箱	688037@kingsemi.com	688037@kingsemi.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，产品包括光刻工序涂胶显影设备（涂胶/显影机、喷胶机）和单片式湿法设备（清洗机、去胶机、湿法刻蚀机），可用于 8/12 英寸单晶圆处理（如集成电路制造前道晶圆加工及后道先进封装环节）及 6 英寸及以下单晶圆处理（如化合物、MEMS、LED 芯片制造等环节）。

作为公司标杆产品，光刻工序涂胶显影设备系集成电路制造过程中不可或缺的关键处理设备，主要与光刻机（芯片生产线上最庞大、最精密复杂、难度最大、价格最昂贵的设备）配合进行作业，通过机械手使晶圆在各系统间传输和处理，从而完成晶圆的光刻胶涂覆、固化、显影、坚膜等工艺过程。作为光刻机的输入（曝光前光刻胶涂覆）和输出（曝光后图形的显影），涂胶/显影机的性能不仅直接影响到细微曝光图案的形成，其显影工艺的图形质量和缺陷控制对后续诸多工艺（诸如蚀刻、离子注入等）中图形转移的结果也有着深刻的影响。

（二）主要经营模式

1、盈利模式

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售业务，通过向下游公司销售光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备等产品实现收入和利润。报告期内，公司主营业务收入来源于半导体专用设备产品的销售，其他业务收入来源于设备相关配件销售及维修服务等。

2、采购模式

公司主要根据生产订单物料、研发物料、售后服务物料的需求计划和安全库存的需要等制定采购计划，采取与供应商单签合同或签订年度框架合同等方式开展采购。为保证公司产品的质量和性能，公司对供应商进行统一管理，主要考察供应商的资质实力、产品情况、售后服务等方面，经外部供方调查、样品试用或非标准部件定制加工验证通过后确定合格供应商名录，并持续更新及跟踪评级。

3、研发模式

公司以自主研发为主，充分结合产品技术国际发展趋势及客户实际需求，以核心基础技术研究、核心单元零部件研究、整机研发应用并重为原则，确定公司研发方向和研发项目，建立了机械、电气、软件等多模块协同配合，公司级与部门级研发项目相结合的研发创新机制。同时，公司技术管理部负责对研发项目的立项评审，组织下达设计与开发任务，开展跟踪管理、结项验收评价等具体实施管理。

4、生产模式

公司采用在手订单生产为主、潜在订单预投生产为辅的生产模式。公司根据已签单客户以及有明确需求且供期紧张的潜在客户的具体需求进行产品定制化设计及生产制造，以满足客户对产品不同的技术指标和供期的需求，同时也能合理管控公司在产品的规模和呆滞风险。

5、销售模式

公司主要采取“直销为主、代销为辅”的销售模式。直销模式下，公司通过商务谈判、招投标等方式获取订单；委托代理商销售模式下，公司与特定地区代理商签订产品销售区域代理协议，由其负责在特定地区代理销售公司相关产品，公司向其支付一定比例的代理佣金。

公司配备了专业的销售与服务团队，主要负责售前客户需求分析、商务谈判或招投标环节及销售设备的安装、调试、保修、维修、技术咨询及客户端人员培训等售后工作。公司始终秉承“客户第一，为客户创造价值”的营销理念，致力于为客户提供“专业精品”的产品及服务。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）行业的发展阶段、基本特点

半导体被称为制造业皇冠上的明珠，半导体产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，其技术水平和发展规模已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。作为“工业粮食”半导体芯片被广泛地应用于计算机、消费类电子、网络通信、汽车电子、物联网等产业，是绝大多数电子设备的核心组成部分。根据国际货币基金组织测算，每 1 美元半导体芯片的产值可带动相关电子信息产业 10 美元产值，并带来 100 美元的 GDP，这种 100 倍价值链的放大效应奠定了芯片行业在国民经济中的重要地位。

为推动半导体产业发展，增强产业创新能力和国际竞争力，带动传统产业改造和产品升级换代，进一步促进国民经济持续、快速、健康发展，我国先后出台《科技部重点支持集成电路重点专项》、《集成电路产业“十三五”发展规划》、《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》等鼓励和支持半导体设备产业发展的政策，为我国半导体设备行业发展营造了良好的政策环境。2022 年 11 月，辽宁省政府发布了《辽宁省培育壮大集成电路装备产业集群若干措施》，在企业销售规模奖励、投资建设项目、新产品销售奖励、研发费用补助、人才引进激励等多个维度大力支持辽宁省集成电路装备产业发展。

从全球半导体设备行业来看，随着下游电子、汽车、通信等行业需求的稳步增长，以及物联网、AI、云计算及大数据等新兴领域的快速发展，集成电路产业面临着新型芯片带来的产能扩张需求，为半导体设备行业带来广阔的市场空间。2022 年 12 月，SEMI 发布了《2022 年度总半导体设备预测报告》。根据 SEMI 数据，2022 年全球晶圆厂前道设备投资将达到 948 亿美元的新行业纪录，同比增长 8.3%。SEMI 预计，2023 年受全球半导体库存调整等因素影响，晶圆厂前道设备投资将降至 760 亿美元，并将在汽车和计算领域以及一系列新兴应用驱动下在 2024 年复苏至 920 亿美元。

从我国半导体设备行业来看，集成电路产业国际产能不断向我国大陆地区转移，据 SEMI 统计，2016-2021 年，我国大陆的半导体设备市场规模从 64.60 亿美元增长至 296 亿美元，近五年来年均复合增长率达到 35.58%，远高于全球市场增速。2022 年下半年受多重因素交叠影响，国内晶圆厂扩产增速进入放缓阶段，SEMI 在随后的报告中指出，国内半导体的长期强劲需求后续仍将推动产能扩张，全球市场份额整体占有率将由 2022 年的 22%增加到 2026 年的 25%，达到每月 240 万片晶圆。

（2）主要技术门槛

公司所处的半导体设备行业属于典型的技术密集型行业，涉及电子、机械、化工、材料、信息等多学科领域，是多门类跨学科知识的综合应用，具有较高的技术门槛。半导体设备行业涉及国家基础科学综合实力的比拼，具有技术壁垒高、价值量高、研发周期长等特点。由于半导体工艺流程复杂，对设备依赖度较高，设备性能直接影响半导体制造的产品品质、工艺效率及良率，最终影响到半导体企业的盈利能力和全球竞争力。因此，要想实现中国半导体产业自主可控模式的崛起，完成设备环节的国产化是其至关重要的环节之一。目前，以美国应用材料、荷兰阿斯麦、美国泛林集团、日本东京电子、美国科天等为代表的国际知名企业仍占据全球半导体设备市场的主要份额。在需求拉动和国家支持下，我国半导体产业链得以不断完善，但仍然存在供给能力不足的问题，我国半导体市场国产替代存在较大市场空间。伴随着国家鼓励类产业政策和产业投资基金不断的落实与实施，我国半导体设备行业迎来了前所未有的发展契机，半导体设备的国产化进程将不断推进。

以公司生产的前道涂胶显影设备为例，作为晶圆生产过程中配合光刻机工作的重要工艺设备，其产品结构复杂（包括约十余个功能模块组及配套机器人）、单元众多（百余个功能单元），配件繁杂（数万余个零部件），同时还要确保平均每小时数千次的机械运动速度。前道涂胶显影设备技术涵盖机械运动、温湿度及内环境控制、系统调度及控制、化学反应及化学品管控等，是多学科高度集成的现代高科技装备，对生产厂商的技术储备、工艺水平提出了较高要求。此外，影响前道涂胶显影机实现量产销售的难点还包括客户端工艺验证，需要协调下游晶圆厂在不影响其生产线正常生产的情况下，提供光刻机、掩膜版、检测设备及程序、客户产品片等资源配合。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

半导体设备行业具有较高的技术壁垒、市场壁垒和客户认知壁垒，以美国应用材料、荷兰阿斯麦、美国泛林集团、日本东京电子、美国科天等为代表的国际知名企业占据了全球半导体设备市场的主要份额。

前道涂胶显影设备主要被日本东京电子所垄断，报告期内，公司前道涂胶显影机 offline、l-line、KrF 机台均实现批量销售。2022 年第四季度，随着公司前道涂胶显影机 ArFi 机台的推出，标志着公司前道涂胶显影设备已完成在晶圆加工环节 28nm 及以上工艺全覆盖，并可持续向更高工艺等级迭代。

公司生产的前道物理清洗机 Spin Scrubber 设备较为成熟，已成为国内晶圆厂 baseline 产品。报告期内，产品在高产能清洗架构、颗粒去除能力等指标上实现了进一步的提升，产品竞争力不断增强，国内市占率稳步提升。

公司在集成电路制造后道先进封装、化合物等小尺寸领域深耕多年，凭借持续的技术创新、高性价的产品及优质的售后服务，持续巩固国内领先地位。近年来作为主流机型已批量应用于台积电、长电科技、华天科技、通富微电、三安集成、北京赛微微、江西兆驰等国内一线大厂。报告期内，公司加深与盛合晶微、长电绍兴、上海易卜等国内新兴封装势力的合作关系，成功实现各类设备的批量导入。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）光刻多重曝光技术

在摩尔定律的推动下，线宽朝着更精细的等级发展，在光刻机波长精度受限的情况下，光刻多重曝光技术带来了新的技术解决方案。如 SADP 技术先利用浸没式光刻机形成节距较大的线条，再利用侧墙图形转移的方式形成 1/2 节距的线条，该技术适合线条排列规则的图形层，如 FinFET 工艺中的 Fin 或后段金属线条。从 SADP 技术还发展出自对准四重图形化（Self-Aligned Quadruple Patterning，SAQP）技术或自对准多重图形化（Self-Aligned Multiple Patterning，SAMP）等技术。光刻多重曝光技术通常需要反复进行涂胶—光刻—显影—刻蚀等工艺流程，由于每一次曝光都需要进行涂胶和显影工艺，光刻多重曝光技术的发展大大增加了涂胶显影设备的潜在需求。

（2）前道涂胶显影机在 SOC、SOG 等技术场景的拓展应用

公司第三代高产能架构可应用于三层光刻涂布工艺，即实现 SOC、SOG 与 PR 的三层涂布结构。整个涂布工艺具有填洞优势，不易产生空穴、平整度高，同时烘烤温度低于传统 CDBR 工艺，可以减少对图案破坏，相对于传统的 CDBR 工艺，同时具备低成本与高性能优势，可有效拓展涂胶显影机的产品应用领域和市场空间。

（3）NTD 负显影技术

负显影技术主要应用于前道高端工艺，其原理为正性光刻胶未被曝光的区域可以被 NTD 显影液去除，而曝光区域则在显影后留下，实现了类似负性光刻胶的曝光特性。报告期内，公司成功突破了在 NTD 负显影工艺中显影高损伤、防静电击穿等技术瓶颈，可为客户提供更丰富的产品技术解决方案。

（4）Chiplet（芯粒）封装技术

在摩尔定律逐渐放缓的情况下，Chiplet 技术已成为持续提高集成度和芯片算力的重要途径之一。根据 Gartner 预测，基于 Chiplet 的半导体器件的整体销售收入预计从 2020 年的 33 亿美元增长到 2024 年的 505 亿美元，年复合年增长率高达 98%。在应用各项底层先进封装技术支持 Chiplet 的工艺场景下，为了满足更多层的互联工艺要求，通常需要经过更多的图形化道次，催生了更多后道涂胶显影、湿法类工艺需求。

此外，在 Chiplet 技术中，为了缩小芯片体积、提高芯片散热性能和传导效率等，晶圆减薄工艺会被大量应用，为了不损伤减薄中以及减薄后晶圆，需要将晶圆片与玻璃基板临时键合并在完成后续工艺后最终解键合。同时在 Chiplet 技术路线下，Fan-out、CoWoS 等封装工艺路线都要经过单次或多次的临时键合及解键合工艺来实现芯粒互联。针对以上半导体工艺应用场景，公司已成功研发临时键合机、解键合机产品，目前临时键合机正在进行客户端验证。

（5）SiC 行业发展

与传统半导体材料相比，以 SiC 制成的器件拥有良好的耐热性、耐压性和极低的导通能量损耗，是制造高压功率器件与高功率射频器件的理想材料。SiC 下游应用包括新能源、光伏、储能、通信等领域。据 Yole 预计，全球 SiC 功率半导体市场规模将从 2021 年的 11 亿美元增长至 2027 年的 63 亿美元，CAGR 超过 34%。公司通过在 SiC 设备领域提前布局，已向国内多家 SiC 龙头厂商实现批量销售。

公司是国内涂胶显影领域龙头，经过多年发展，产品已完整覆盖前道晶圆加工、后道先进封装、化合物半导体等多个领域，下游客户包括国内各大前道晶圆厂、后道封装厂及化合物半导体厂商。报告期内，公司积极探索新技术路线，并与下游客户保持了深度的合作关系，力争为客户提供更具价值的产品技术解决方案。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	3,496,333,727.06	1,960,914,071.65	78.30	1,224,599,920.37
归属于上市公司股东的净资产	2,106,541,950.00	897,248,075.62	134.78	798,597,040.69
营业收入	1,384,867,131.46	828,672,512.29	67.12	328,900,200.07
归属于上市公司股东的净利润	200,160,932.53	77,349,494.43	158.77	48,828,560.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,247,261.68	63,838,961.51	114.99	12,875,142.25
经营活动产生的现金流量净额	192,963,939.50	-218,325,429.94	不适用	-72,389,945.01
加权平均净资产收益率(%)	13.36	9.20	增加 4.16 个百分点	6.31
基本每股收益(元/股)	2.27	0.92	146.74	0.58
稀释每股收益(元/股)	2.27	0.92	146.74	0.58
研发投入占营业收入的比例(%)	10.99	11.16	减少 0.17 个百分点	13.81

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	183,711,477.74	320,545,863.93	392,427,217.36	488,182,572.43
归属于上市公司股东的净利润	32,413,462.53	36,993,260.50	73,620,027.54	57,134,181.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,333,045.86	34,449,715.57	33,345,495.16	38,119,005.09
经营活动产生的现金流量净额	-1,281,105.15	112,853,541.23	-55,192,419.95	136,583,923.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	10,573
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,579
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	有条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
							股份状态	数量	
沈阳先进制造技术产业有限公司	-3,632,647	10,699,783	11.55	0		0	无	0	境内非国有法人
中国科学院沈阳自动化研究所	0	10,500,000	11.34	0		0	无	0	国有法人
辽宁科发实业有限公司	-900,000	9,032,820	9.75	0		0	无	0	国有法人
中国科技产业投资管理有限公司	-1,850,000	3,265,000	3.53	0		0	无	0	国有法人
宗润福	-484,545	2,165,455	2.34	0		0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	2,043,380	2,043,380	2.21	0		0	无	0	其他
周冰冰	-1,028,745	1,946,005	2.10	0		0	无	0	境内自然人
银华基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	1,368,268	1,368,268	1.48	0		0	无	0	其他
李凤莉	-338,750	1,061,250	1.15	0		0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	888,000	888,000	0.96	0		0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售。2022 年度，公司实现营业收入 138,486.71 万元，实现净利润 20,016.09 万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：688037　证券简称：芯源微　公告编号：2023-019

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

- 分配比例：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）；
- 转增比例：公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.8 股，不送红股；
- 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况；
- 本年度现金分红比例低于 30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑；
- 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 200,160,932.53 元，公司期末可供分配利润为人民币 260,876,895.61 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。截至本公告日，公司总股本为 92,618,399 股，以此计算合计拟派发现金红利 37,047,359.60 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 18.51%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.8 股，不送红股。截至本公告日，公司总股本为 92,618,399 股，公司拟合计转增 44,456,831 股，转增后公司的总股本增加至 137,075,230 股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

（一）公司所处行业情况及特点

半导体设备行业是一个全球化程度较高的行业，受国际经济波动、半导体市场、终端消费市场需求影响，其发展往往呈现一定的周期性波动。当宏观经济和终端消费市场需求变化较大时，半导体生产厂商会调整其资本性支出规模和对半导体设备的采购计划，从而对半导体设备公司的营业收入和盈利产生影响。在全球贸易争端不断、世界经济增长放缓、国内经济下行压力加大的背景下，全球半导体设备产业呈现震荡发展态势。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售业务，通过向下游公司销售光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备等产品实现收入和利润。报告期内，公司主营业务收入来源于半导体专用设备产品的销售，其他业务收入来源于设备相关配件销售及维修服务等。

公司所处的半导体设备行业属于技术、资金密集型行业，具有产品技术升级快、研发投入大等特点。目前公司处于快速发展阶段，需要持续投入大量资金用于新产品的研发以及市场化，进一步提升公司的产能规模和综合竞争实力，同时完善公司的产业链布局。

（三）公司盈利水平及资金需求

报告期内，归属于上市公司股东的净利润 20,016.09 万元，同比增长 158.77%，公司盈利能力不断增强，整体财务状况向好。

2023 年，公司的资金需求主要体现在公司新产品的研发及市场化、提升公司的产能规模、完善公司的产业链布局等方面。

（四）公司现金分红水平较低的原因

综合考虑公司所处行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求，公司制定了 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案，以保障公司的可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司 2022 年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和项目投资带来的营运资金的需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：“公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时兼顾全体股东利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。综上，我们同意《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并提交公司股东大会审议。”

（三）监事会意见

2023 年 4 月 17 日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

监事会认为：“公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时考虑投资者的合理诉求。该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们同意本次利润分配及资本公积转增股本方案。”

四、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、上网公告附件

沈阳芯源微电子设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日

证券代码：688037　证券简称：芯源微　公告编号：2023-021

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”或“芯源微”）拟将募集资金投资项目之一“高端晶圆处理设备产业化项目（二期）”实施地点由“辽宁省沈阳市浑南区彩云路 1 号”变更为“北至规划路，南至创新路，西至沈本大街，东至沈本一街地块”。
- 上述募投项目实施地点变更不改变或变相改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

2023 年 4 月 17 日，公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金项目的承诺，以及中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略。综上，我们同意《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

（二）监事会意见

公司本次变更部分募投项目实施地点，是公司根据经营实际需要作出的合理决策，有利于募投项目的实施和推进。本次变更部分募投项目实施地点，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，以及中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略。综上，我们同意《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

（三）监事会意见

公司本次变更部分募投项目实施地点，是公司根据经营实际需要作出的合理决策，有利于募投项目的实施和推进。本次变更部分募投项目实施地点，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，以及中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略。综上，公司监事会同意公司本次变更部分募投项目实施地点。

（三）保荐机构意见

公司本次变更部分募投项目实施地点的事项已履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次变更部分募投项目实施地点未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目产生实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形。综上，保荐机构同意芯源微本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项。

七、上网公告附件

（一）沈阳芯源微电子设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见；

（二）中国国际金融股份有限公司关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日

证券代码：688037　证券简称：芯源微　公告编号：2023-017

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳芯源微电子设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2019］2335 号）同意注册，沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 26.97 元，应募集资金总额为 566,370,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 60,625,896.22 元后，实际募集资金净额为 505,744,103.78 元。以上募集资金已于 2019 年 12 月 10 日到位，募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具会验字［2019]8294 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意沈阳芯源微电子设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2022]498 号），公司于 2022 年 6 月向特定对象发行人民币普通股股票 8,045,699.00 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 124.29 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,928.71 元，扣除不含税的发行费用人民币 9,915,093.67 元，实际募集资金净额为人民币 990,084,835.04 元。以上募集资金已于 2022 年 6 月 8 日到位，募集资金到位情况已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具容诚验字[2022]110Z0008 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

2022 年度，本公司 2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况为：（1）对募集资金项目投入 49,789,523.28 元，其中：高端晶圆处理设备产业化项目 49,176,566.17 元，高端晶圆处理设备研发中心项目 612,957.11 元；（2）使用节余募集资金补充流动资金 9,284,650.48 元；（3）归还闲置募集资金暂时补充流动资金 60,000,000.00 元；2022 年度公司累计使用募集资金 109,074,173.76 元，支付银行手续费（不含增值税）4,226.47 元，募集资金专用账户利息收入为 941,994.84 元，募集资金专用账户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 4,303,337.01 元。

单位：人民币元

项目	累计金额
募集资金净额	505,744,103.78
减：截至 2022 年 12 月 31 日直接对募集资金项目投入	387,316,021.56
其中：高端晶圆处理设备产业化项目	248,133,621.56
高端晶圆处理设备研发中心项目	139,182,400.00
减：截至 2022 年 12 月 31 日使用闲置资金永久补充流动资金	76,600,000.00
减：截至 2022 年 12 月 31 日使用闲置资金暂时补充流动资金	190,000,000.00
减：截至 2022 年 12 月 31 日节余募集资金补流	9,284,650.48
加：截至 2022 年 12 月 31 日募集资金理财收益	11,579,663.95
加：截至 2022 年 12 月 31 日募集资金利息收入扣除手续费净额	10,180,241.32
加：截至 2022 年 12 月 31 日归还暂时补充流动资金	140,000,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	4,303,337.01

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

2022 年度，本公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况为：对募集资金项目投入 228,937,980.68 元，其中：上海临港研发及产业化项目 88,843,641.77 元，补充流动资金 140,094,338.91 元。2022 年度公司累计使用募集资金 228,937,980.68 元，支付银行手续费（不含增值税）2,969.92 元，募集资金专用账户利息收入为 2,247,786.66 元，使用暂时闲置募集资金购买理财产品所得投资收益 9,877,238.54 元，募集资金专用账户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 783,184,003.31 元。具体明细如下：

项目	累计金额
募集资金总额	999,999,928.71
减：截至 2022 年 12 月 31 日直接对募集资金项目投入	228,937,980.68 218,843,641.77
其中：临港研发及产业化项目	88,843,641.77
高端晶圆处理设备产业化项目(二期)	–
补充流动资金项目	140,094,338.91
加：截至 2022 年 12 月 31 日募集资金理财收益	9,877,238.54
加：截至 2022 年 12 月 31 日募集资金利息收入扣除手续费净额	2,244,816.74
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	783,184,003.31

二、募集资金管理情况

公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，于 2019 年 4 月 24 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于制定＜募集资金管理办法＞的议案》。《募集资金管理办法》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

1、公司于 2019 年 12 月 11 日分别在中信银行沈阳和平支行（账号 8112901012900643057）、中国建设银行沈阳城内支行（账号 21050139000800001255）、招商银行沈阳浑南西路支行（账号 124904600110111）开设账户作为募集资金专项账户。2019 年 12 月 11 日，公司分别与中信银行股份有限公司